

2023. 6. 21 新闻发布

本公司收到了用于三维封装以及扇出式封装工艺的 晶圆处理系统设备的大量订单

艾美柯结束株式会社（AIMECHATEC, Ltd.，总部：日本茨城县龙崎市向阳台，社长：阿部猪佐雄），自接管半导体解键合工艺业务以来，已收到了巨头OSAT（Outsourced Semiconductor Assembly and Test）公司对晶圆处理系统设备的订单，特此发布。

尽管业界一直在小型化和集成化方面相互竞争，但前端工艺的光刻技术已经接近其物理极限，相反，后工程的封装工艺正在蓬勃发展。随着5G，物联网服务器、高性能计算机和自动驾驶市场不断增长，对高性能、超高速和低功耗的需求正在逐年增加。这些背景和需求正在推动三维封装（2.5D和3D）和扇出式（FANOUT）半导体封装市场的发展，此外，在封装工艺上，减薄和堆叠的需求也在日益增加。

本公司的晶圆处理系统设备在上述减薄和堆叠晶圆的过程中发挥着至关重要的作用，并且品质稳定也是本公司的一大特点。通过将多年来致力于临时键合以及解键后清洗等工艺技术与本公司制造能力相结合，我们能够在满足交期的大前提下，提供高性能的晶圆处理系统设备。

综上，多家巨头OSAT公司对本公司的设备给予了高度评价，从而收获了大批订单。此外，我们也收到以海外客户为主的海量咨询。在对高质量和良率的需求日益增加的今天，越来越多的客户正在考虑采用我们的设备，以实现提高产量的目标。

本公司依旧本着通过制程工艺上的不断创新，以达到创造更方便更丰富的生活方式，为社会做出更多的贡献而努力。

咨询：艾美柯技术株式会社

营业部 TEL：0297-62-9119

<https://www.ai-mech.com>